



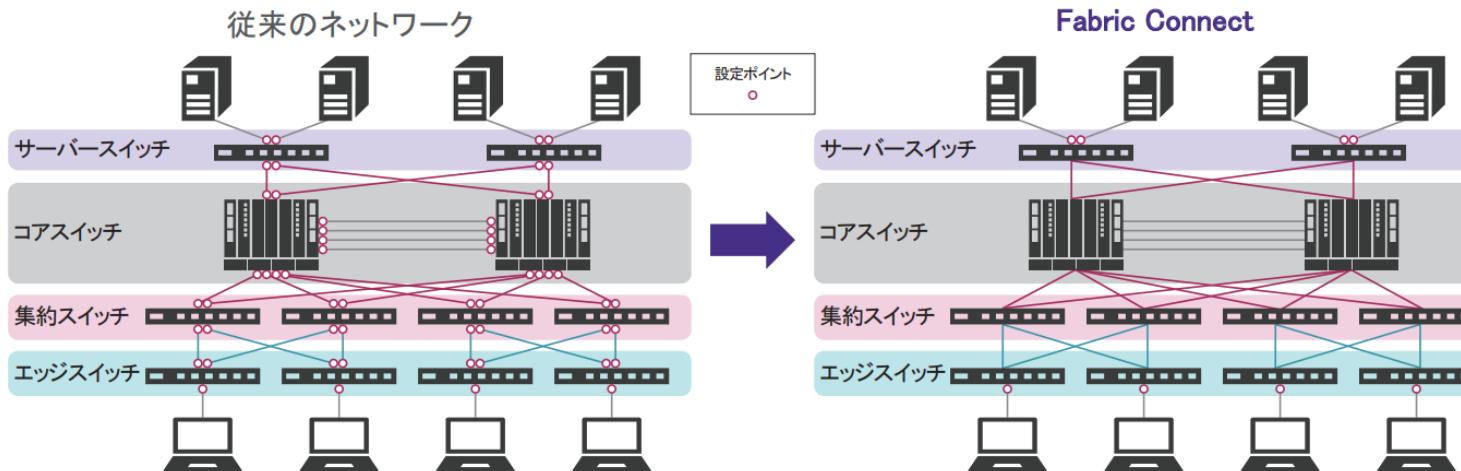
つながる工場を守る！ OT セキュリティ最前線

東京エレクトロン デバイス株式会社
EC BU クラウドIoTカンパニー
IIoTソリューション部
吉川 義洋

特徴

- ◆ 高性能かつ低消費電力のAP
- ◆ 3rdパーティ製品を含めた有線・無線の統合管理が可能
- ◆ 全機能を網羅したシンプルな管理系ライセンス、プール型で自動割り当て、使い回しが可能
- ◆ Fabric Connectの技術による柔軟で拡張性のある堅牢なネットワーク構築を実現

Fabric Connect



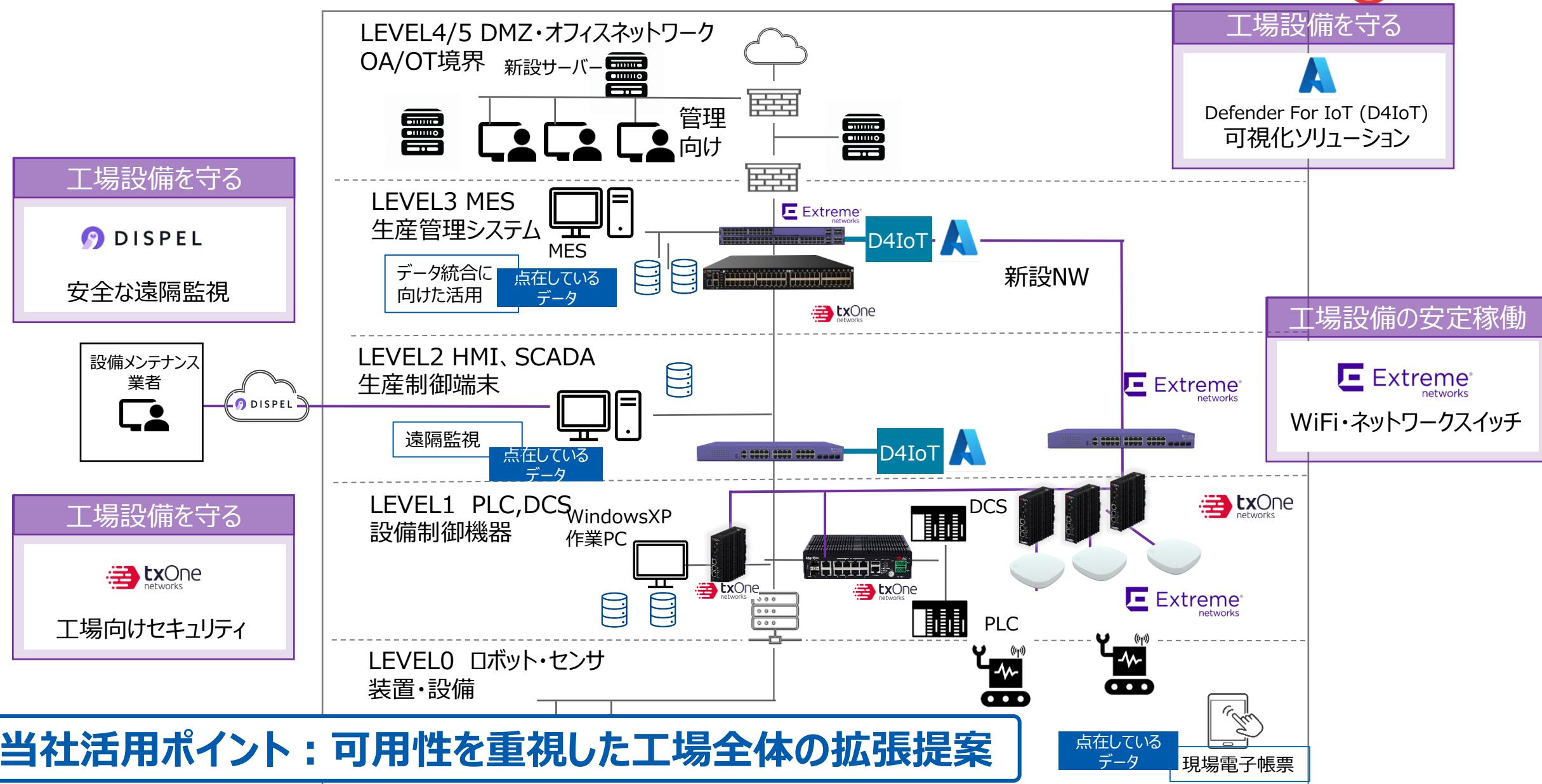
Fabric Connectとは
ネットワーク末端のスイッチに新たな設定を追加するだけで、最適な経路と冗長性を確保し、設定作業の簡略化や人的ミスを削減が可能

複雑な設定なしに、最適な道でデータを超高速・安定的に送ることが可能

製造業におけるFabric Connectのメリット

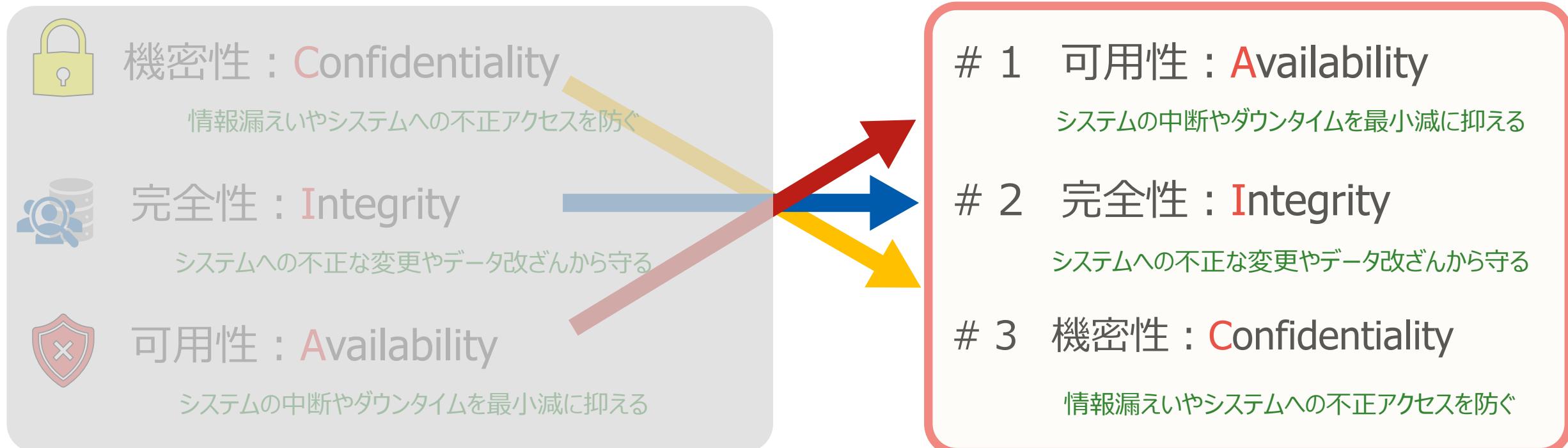
- ◆ 一部のNWに障害が発生した際も、他の道を探し、効率的に切り替わるため、生産ラインを止めずに稼働を続けられる
- ◆ 生産ラインの変更や、新しい機械を導入する際も、複雑な設定変更なく利用できるため、柔軟に対応ができる

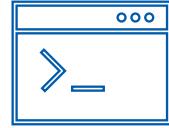
DXを推進するための環境整備ソリューション



● ITセキュリティとOTセキュリティの違い : OTでは可用性が最も重要

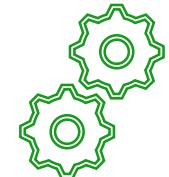
製造ラインやインフラ設備などでは連続稼働（可用性）が最も重要視される。攻撃者視点では、産業用制御システムや物理的な機器自体が対象となり、結果としてシステム停止や最悪の場合は人命に関わるリスクが生じる。システム停止攻撃としては、DDoS（Distributed Denial Service : 分散型サービス拒否）攻撃が代表例だが、ランサムウェア攻撃やゼロデイ脆弱性の悪用については、IT・OTの区別なく共通の脅威となり得る。DX化によるITとOTの融合により、OTネットワークへのリスクが増加され、攻撃対象領域（アタックサーフェイス : Attack Surface）が拡大する。





技術的課題

- システムはリアルタイム処理が要求されるため、**装置のCPUやメモリに負荷をかけられない**
- レガシーOS端末**にセキュリティソフトをインストールできない（サポート終了、スペック不足等）
- セキュリティソフトの展開時にシステムや端末の**再起動が発生**し、生産活動に影響がでる
- ネットワークが適切にセグメンテーションされていない、ネットワーク**構成の変更が難しい**
- リモートメンテナンスやリモート制御等の**外部からの通信**のセキュリティ対策が不十分



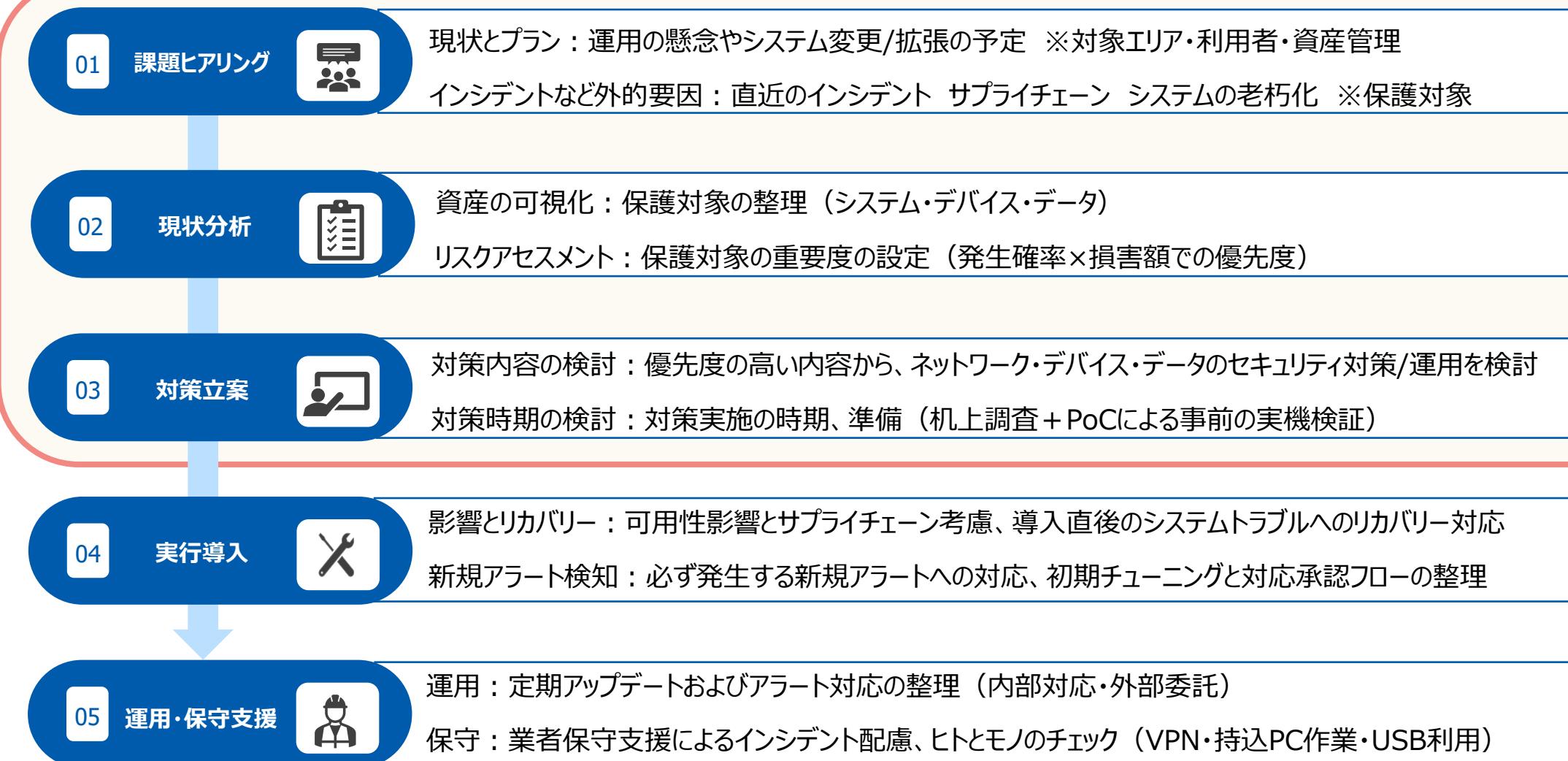
運用的課題

- ネットワーク構成や**資産を把握できていない**（**クローズド環境**も大きく影響）
- 外部業者によるシステムメンテナス時に接続される**作業用PCのチェック・管理**が不十分
- 計画停止時以外はシステムを**停止できない**、オンライン**アップデートできない**
- システムは10~20年の**長期利用を前提**としており、搭載OSのサポート切れが発生する
- システムにセキュリティソフトウェアをインストールするとメーカーの**動作保証外**となる



人・組織的課題

- ITシステムは情報システム部門、OTシステムは製造・設備部門の**責任範囲**となっている
- サイバーセキュリティの**専門スキルを有した人材がいない**
- 経営層にセキュリティ対策の**重要性が理解されず**、予算負担部門も不明（コスト意識）
- DXの推進により、幅広い部門がシステム開発・運用を行うため**ステークホルダ**が増える





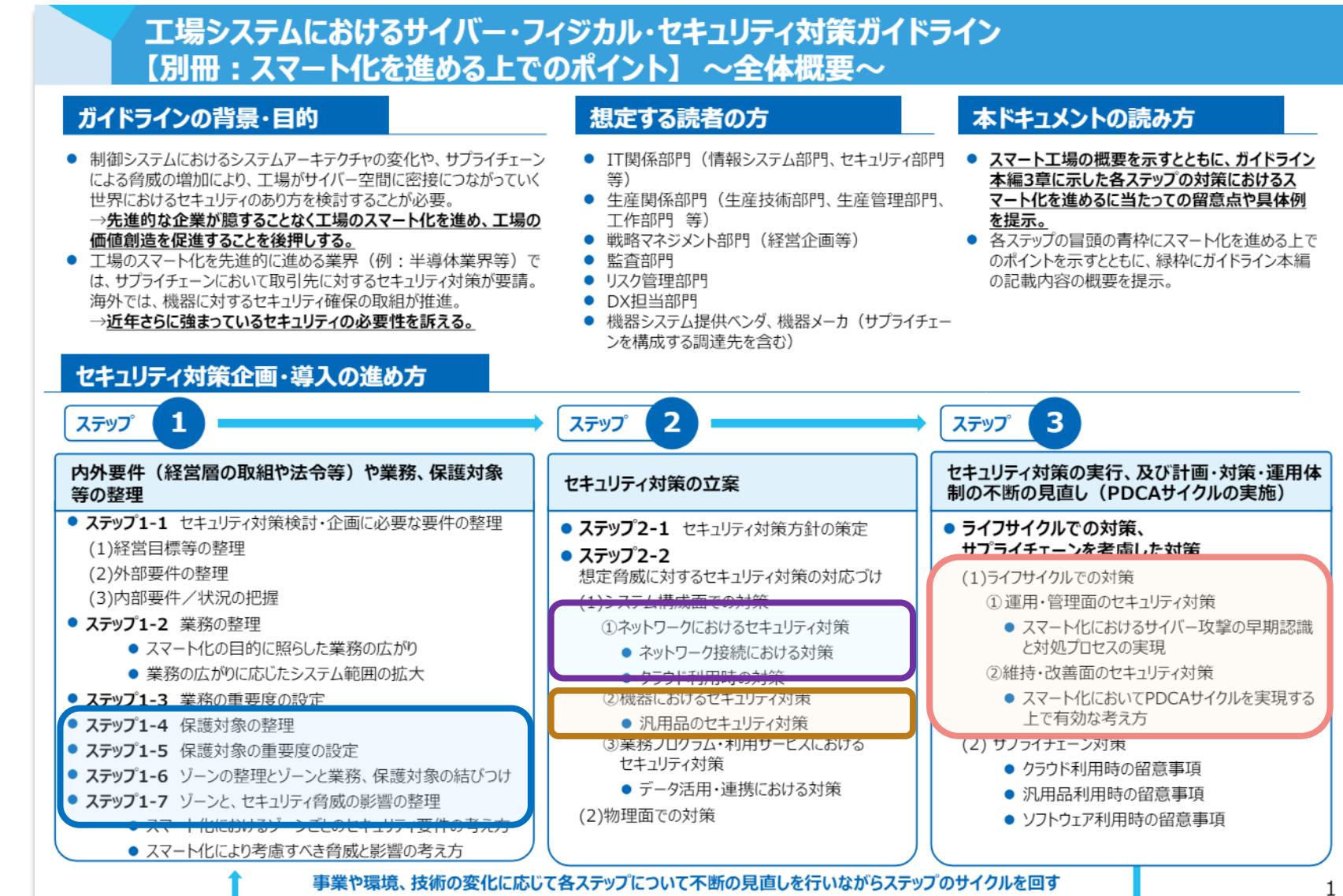
2022年11月：Ver1.0 発行
2024年04月：別冊発行

現状分析（資産・データ可視化）
資産情報（台帳作成）
通信の可視化、リスク優先度判定

ネットワーク対策：産業用IPS、FW
リスクの可視化：産業用IDS、NDR

デバイス対策：産業用AV/許可リスト型

運用、維持改善：PDCAサイクルの実施



引用元：経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/wg1/factorysystems_guideline_appendix.pdf



「半導体デバイス工場におけるOTセキュリティガイドライン（案）」概要資料

商務情報政策局 サイバーセキュリティ課・情報産業課

2025年6月27日：60日間のパブリックコメント開始

- 最も高度な攻撃を想定した対策レベルの指針
- リスクベースのサイバーセキュリティフレームワーク
- NIST CSF2.0、SEMI E187/E188との整合
- 半導体工場の特徴を踏まえたリスクへの対策項目
- Purdueモデルで分類したエリアについての対策
- 組織・ヒト側面についての対策

2022年に公表した「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン」は、一般的な工場向けとなっており、**工場の規模が大きく、汎用OSを用いた製造装置の台数が多いなどの特徴を有する半導体工場にはなじまない実態**があり、2024年11月から半導体工場のあり方について議論、国際的な半導体産業における規格に準拠したガイドライン（案）を取りまとめ、**国内外の利害関係者からの意見をいただくパブリックコメントを実施**。

半導体デバイス工場におけるOTセキュリティガイドライン～全体概要～

ガイドラインの背景と目的

- 半導体産業の経済及び安全保障上の重要性や足下でのサイバーフィジカルリスクの高まりを踏まえると、高度なサイバー攻撃への対応を含めたセキュリティ対策を進めていく必要がある。
- 海外では、国際的な半導体関連の業界団体であるSEMIにより、半導体製造装置に係るE187/E188規格が策定され、米国標準技術研究所（NIST）においてもCybersecurity Framework 2.0（以下、NIST CSF 2.0）について、半導体製造プロファイルの策定が進んでいる。
→国際的な半導体産業における各種セキュリティ規格と整合しつつ、生産目標の維持・機密情報保護・半導体品質の維持のための工場セキュリティ対策の指針を示す。

本ガイドラインの活用方法

- 本ガイドラインは、主に半導体デバイスメーカーの製造部門（実務者レベル）を対象としており、サイバースペースとフィジカル空間を統合的に保護するための基本原則と具体的な指針を定めたサイバーフィジカルセキュリティ対策フレームワーク（以下、CPSF）やNIST CSF2.0等リスクベースのフレームワークを活用したリスク分析、セキュリティ対策の検討をする際の参考資料として活用することができる。

組織プロファイルの作成

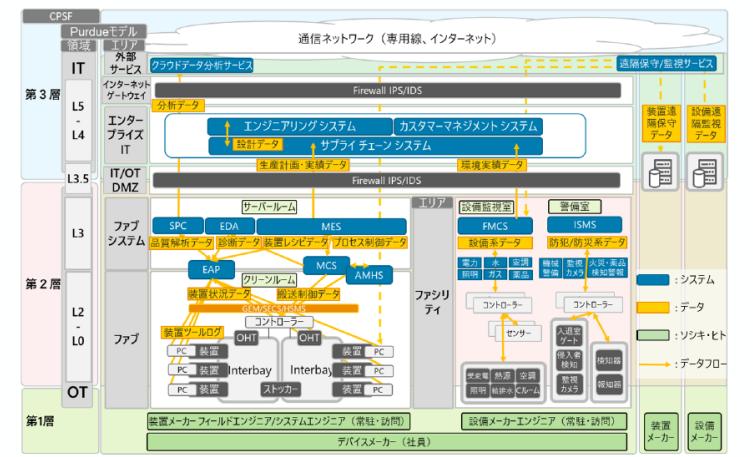
本ガイドラインの第3章の特徴及び考慮すべき観点に記載されている内容を参考に、サブカテゴリ毎の現状の把握と目標の設定

行動計画を策定

組織プロファイルの現状と目標のギャップ分析から行動計画を策定するにあたり、本ガイドラインの第3章に記載されているCPSFの対策要件IDやE187製造リファレンス、及び第4章に記載されている対策例を参照

本ガイドラインで示す対策項目

- 半導体デバイス工場のリファレンスアーキテクチャに基づき、リスク対策フレームワーク（CPSF及びNIST CSF2.0）を活用し、半導体デバイス工場の特徴を踏まえたリスク源（脅威、脆弱性）の洗い出しを行うとともに、対応するセキュリティ対策項目について取りまとめた。
- Purdueモデルで分類したファブエリア、ファブシステムエリア、外部サービス及びIT/OT DMZ、組織・ヒト側面について対策項目を整理した。



● 半導体セキュリティ規格 : SEMI規格 (Semiconductor Equipment and Materials International E187/E188)

半導体製造に関して、産業の発展を目指す団体「SEMI（2000社以上が所属）」による、半導体製造装置とその材料の標準化を目的としたガイドライン。各分野ごとにアルファベットで識別（E/装置、M/材料、C/薬液やガスなど）され、2022年にセキュリティ規格としてE187/E188が発行。E187は、Fab装置のサイバーセキュリティ仕様として台湾地区のタスクフォースにて開発され、E188は、マルウェアフリー装置組込みの為の仕様として北米地区のタスクフォースにて開発された。E187が装置開発・導入フェーズのWindows/LinuxOS搭載装置にフォーカスされる。E188では導入・運用・保守フェーズでのマルウェアスキャンや脆弱性チェックを要求している。罰則は無いが、準拠を前提としてビジネスが展開されている。



SEMI初となるサイバーセキュリティ規格を出版

SEMI本部, International Standards, EHS & Sustainability, Senior Director, James Amano

近年、企業に対するサイバー攻撃が急増しており、半導体業界に影響を及ぼしています。

例えば、2018年にランサムウェアに感染した装置を調査するために、大手ファウンドリーが一時操業の停止を余儀なくされました。

将来起こりうるサイバー攻撃から工場設備を守るために、SEMIは2つの主要なSEMIスタンダード標準化活動を開始し、業界全体の努力の元に次の2つの新しい規格が発表されました。

SEMI E187 - Specification for Cybersecurity of Fab Equipment(ファブ装置のサイバーセキュリティ仕様)

SEMI E188 - Specification for Malware Free Equipment Integration(マルウェアフリー装置組み込みの為の仕様)

	SEMI E187 ファブ装置のサイバーセキュリティ仕様 2022年1月初版(台湾)	SEMI E188 マルウェアフリー装置組み込みの為の仕様 2022年2月初版(北米)
発効		
対象者	半導体製造装置サプライヤー システムインテグレーター	半導体製造装置サプライヤー HW&SWコボーネントサプライヤー 半導体製造装置ユーザー
目的	半導体製造装置を設計により保護し、運用・保守においてセキュリティ保護をサポートするためのベースラインとして、包括的かつ基本的なサイバーセキュリティの要件を規定	製造設備へのマルウェア伝播を軽減するため、製造装置の納入、設置、サポート活動において求められる情報セキュリティ対策について規定
スコープ	生産設備・マテハン自動化システム・SCADA、PLCは対象外	生産設備・マテハン自動化システム・PLCを含む
推奨実施事項	装置搭載のオペレーティングシステムに関する要求 安全な通信転送プロトコルのサポート ネットワーク構成の技術文書作成 脆弱性の軽減、スキャンの実行 マルウェアスキャンの実行（マルウェアフリー） システムハードニング パッチまたはセキュリティ更新を適用する手順の技術文書の作成 アクセス制御の適用 セキュリティイベントログの管理	* E188と重複事項 安全な通信転送プロトコルのサポート ネットワーク構成の技術文書作成 脆弱性の軽減、スキャンの実行 マルウェアスキャンの実行（マルウェアフリー） システムハードニング
参照規格	E187 4 Referenced Standards and Documentsより SEMI E169 (Guide for Equipment Information System Security : 機器情報システムセキュリティガイド)	E188 12 Related Documentsより SEMI E169 NIST SP800-83 (Guide to Malware Incident Prevention and Handling : マルウェアによるインシデントの防止と対応のためのガイド)
	E187 11 Related Documentsより IEC規格 IEC 62443-1-1, 62443-2-4, 及び62443-3-3	

引用元 : SEMI <https://www.semi.org/jp/standards-watch-2022-March/SEMI-publishes-first-cybersecurity-standards>

サプライチェーン・サイバーセキュリティ・リスク

「セキュリティの樽」

貯められる水の量は最も短い板に依存する。

- 貯められる水の量
= サプライチェーン全体のセキュリティレベル
- 板の長さ
= 各企業のセキュリティレベル

サプライチェーンに関わる組織全体の
セキュリティレベルを高めることが重要



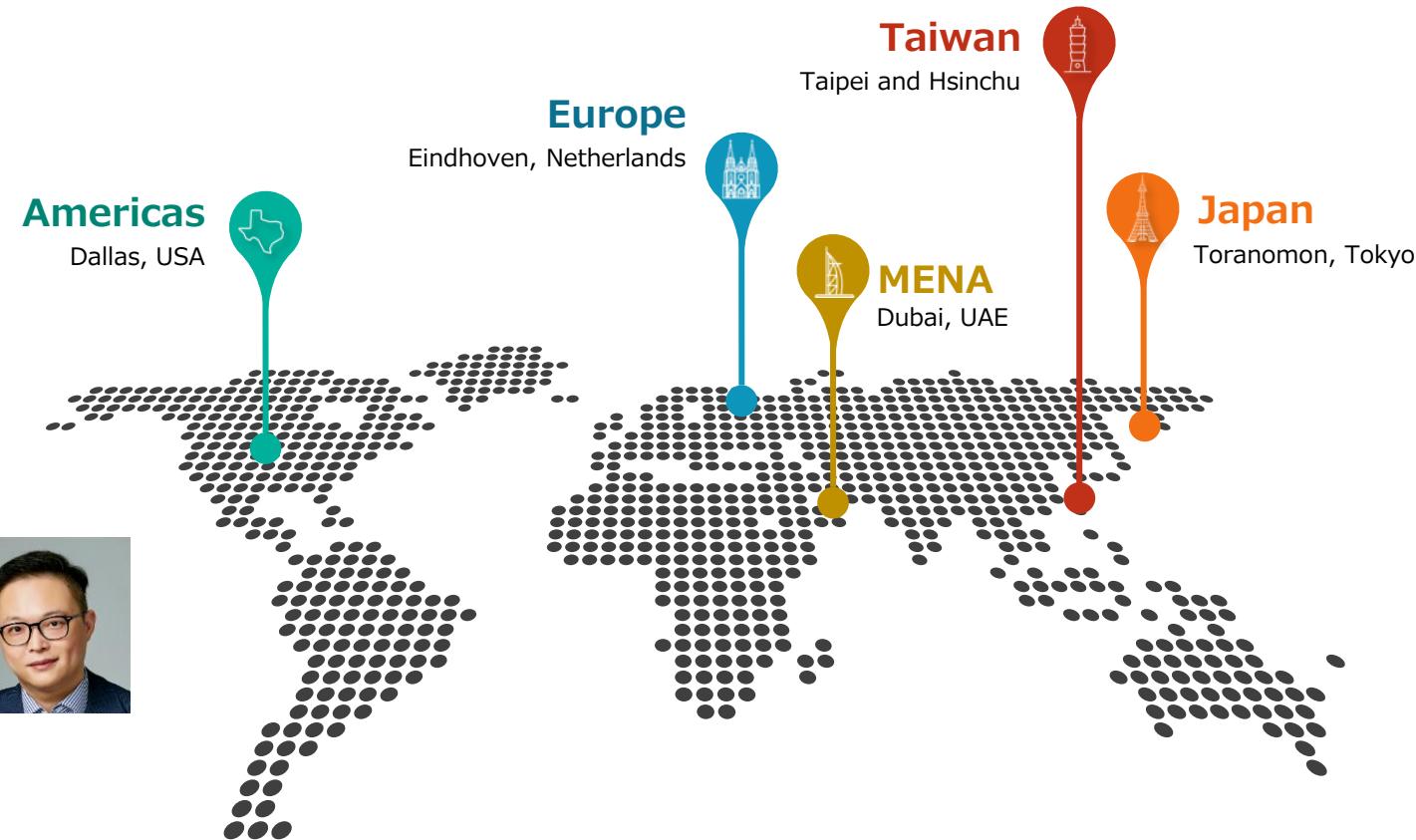
TXOne Networks社 会社概要

Connect Beyond



情報セキュリティのリーディングカンパニーである“トレンドマイクロ”とOTネットワーク製品のリーディングカンパニーである“Moxa”が産業制御システムを保護するサイバーセキュリティ・ソリューションを共同開発することを目的に2019年に設立したOTセキュリティ専業ベンダーです。

会社名	TXOne Networks Inc.
代表取締役社長 (CEO)	Dr. Terence Liu
本社所在地	台湾（台北）
設立	2019年6月
社員数	400名 + ※2024年4月



世界の350社を超える大手企業がTXOne Networksの製品を採用
(半導体製造、半導体装置製造、製薬、自動車製造、航空会社など)

セキュリティ検査

Elementシリーズ



Portable Inspector



ElementOne



Safe Port

OTエンドポイント保護

Stellarシリーズ



OTネットワーク防御

Edgeシリーズ



EdgeOne



EdgeIPS



EdgeIPS Pro



EdgeFire

CPS保護プラットフォーム

SageOne



インストール不要マルウェア検査
持込メディアのサニタイズ

OT環境に最適化された
エンドポイント保護ソフトウェア

生産ラインの安定稼働を
支援する産業向けIPS

TXOne製品の統合管理
プラットフォーム



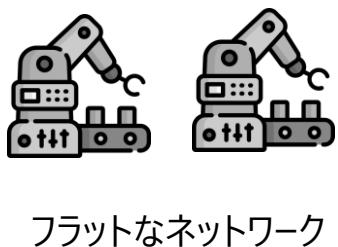
・ レガシー装置

多くのレガシーシステムは、セキュリティソリューションのインストールや、更新によるパッチを当てることができない
(サイバー攻撃へ脆弱さ)



・ 独自性の高い製造ライン

製造ラインの独自性は、セキュリティソリューションのポリシールールのメンテナンスの難易度を上げている
(セキュリティポリシー設定の難易度)



・ フラットなネットワーク

フラットなネットワーク構造のため、ウイルス発生時はネットワーク全体にウイルスが拡散するリスクを抱えている
(有事の際の可用性)

➤ レガシー端末にソフトウェアインストール可能 エンドポイント対応 Stellarシリーズ



➤ レガシー端末にソフトウェアインストール不可の場合 ネットワーク保護 (IPS)



- 仮想パッチによるレガシーシステム保護
- オートルールラーニングによる通信リスト化・管理・制御
- セグメンテーション機能によるウイルス蔓延防止

➤ セキュリティ検査・インシデント対応 マルウェア検査・駆除 Elementシリーズ

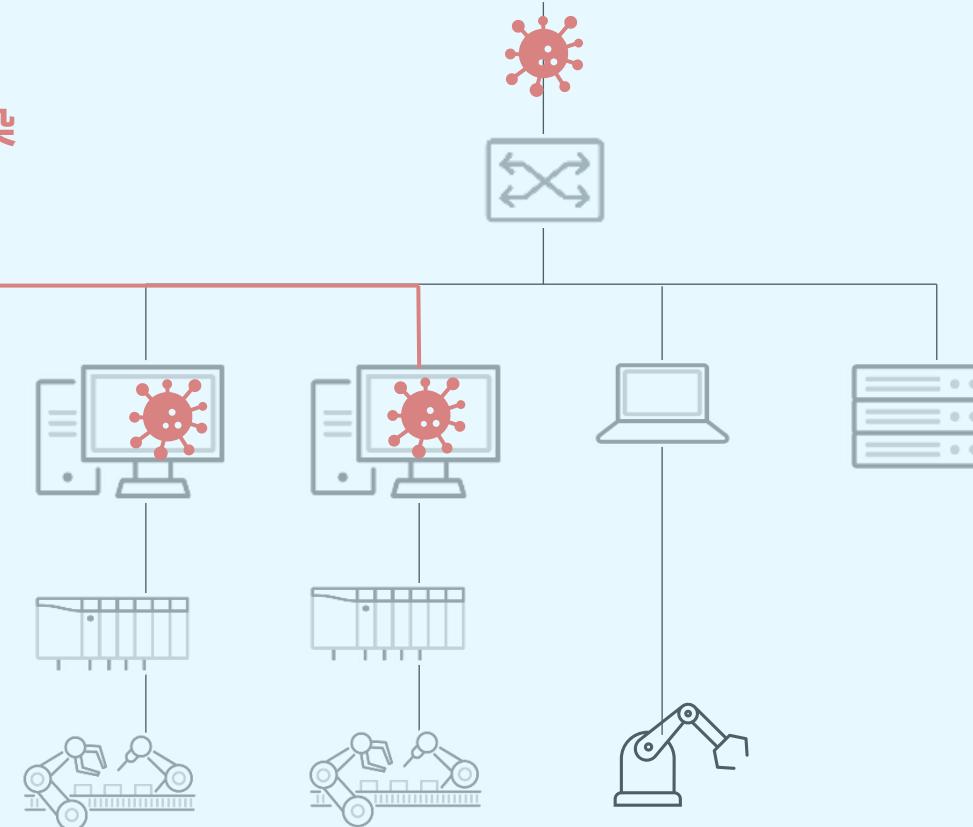


インターネット・イントラネット経由したセキュリティ事故 IT側からの横感染

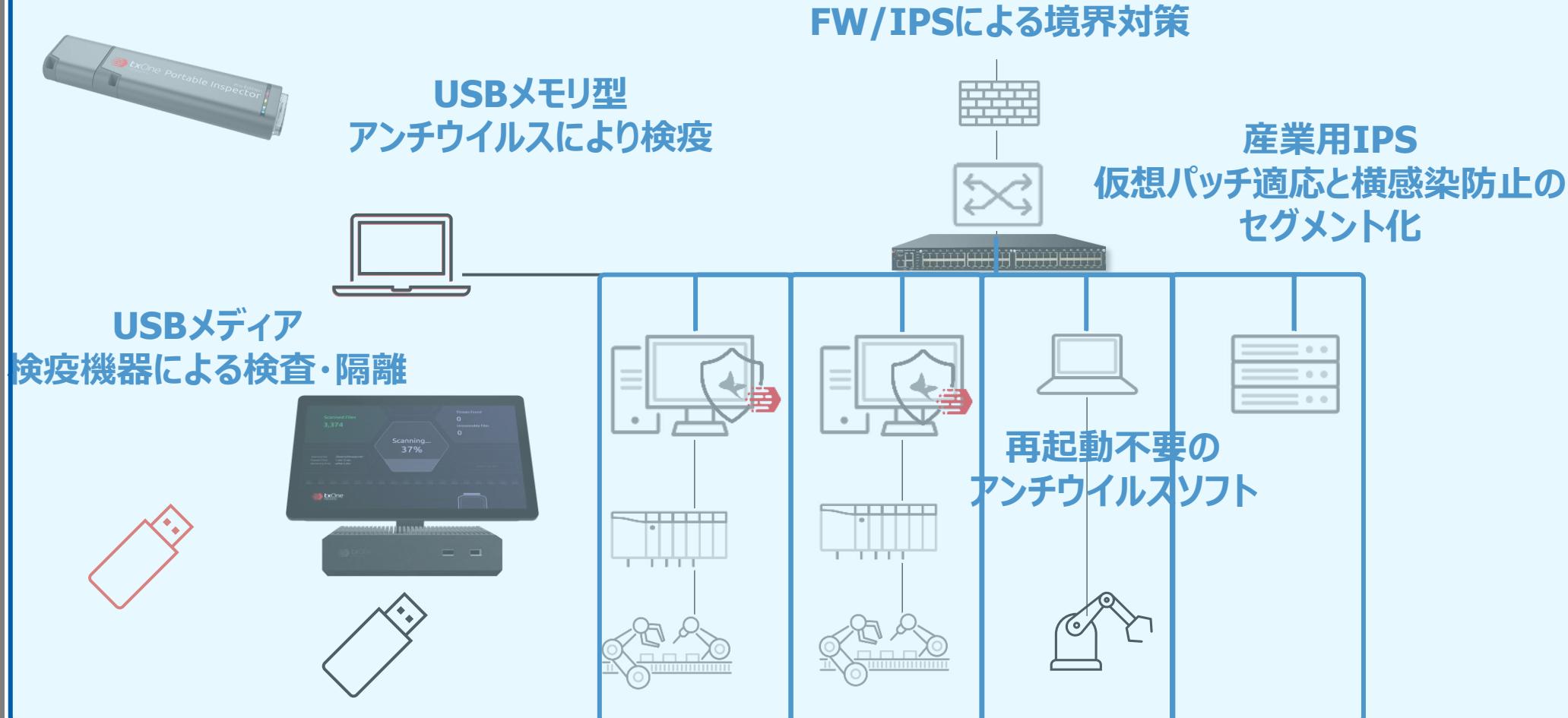
OTメンテナンス時の感染

A red line-art icon of a USB drive, oriented diagonally.

USBメディアにより侵入



制御端末へのアンチウイルスソフトのインストールや、パッチの更新などのサイバーセキュリティ対策が取りにくい

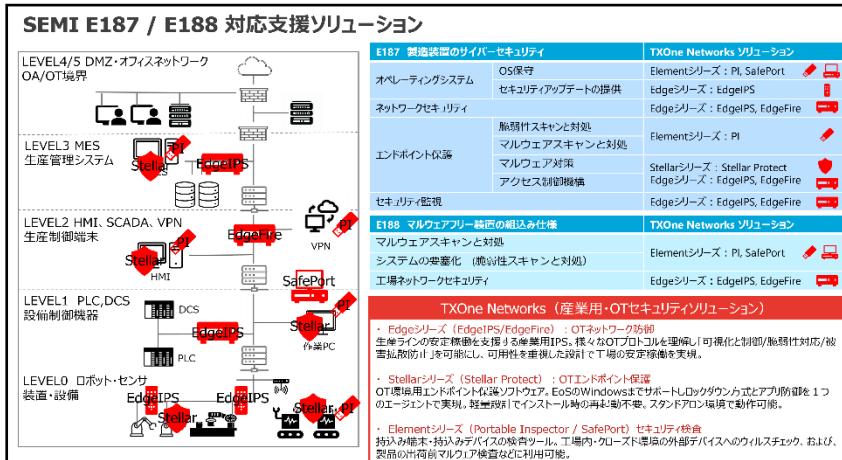


制御端末へのアンチウイルスソフトのインストールや、パッチの更新などのサイバーセキュリティ対策が取りにくい

01 業界動向と工場セキュリティ

半導体関連・各種業界への提案

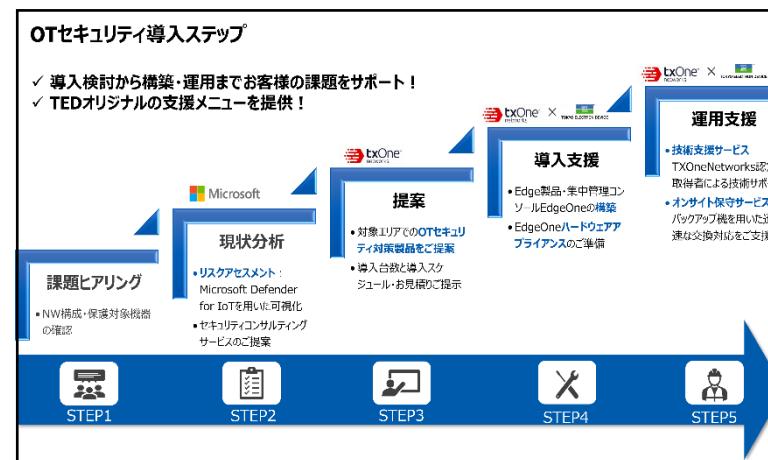
半導体業界に求められる要件を理解した サービス・セキュリティ製品の提供



02 OT向けオリジナルサービス

導入実績に基づくサービス展開

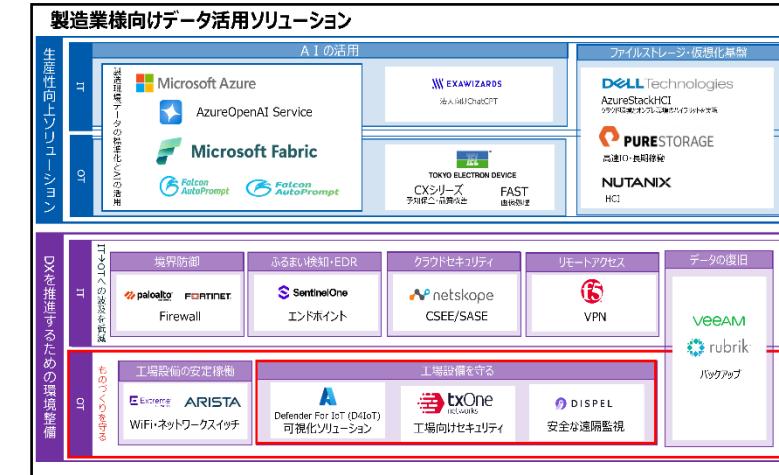
半導体工場を含むEdge製品の国内導入
販売実績3000台以上
導入実績に基づく、当社オリジナルの導入・保守
サービスの提供



03 製造業向けDX支援

デバイス保護からクラウドサービスまで

レガシー機器対応から生成AI活用まで 製造業DXにおける推進支援



- 東京エレクトロンデバイスは、OTセキュリティのトータルソリューションプロバイダーを目指し、TXOne Networks製品をフルサポートし安心してご採用頂き、早期導入頂けるよう、各種サービスを提供致します。

